



(11) RO 127532 B1

(51) Int.Cl.

B01J 19/08 (2006.01).

C01B 19/00 (2006.01),

H01L 21/20 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2010 01036**

(22) Data de depozit: **29/10/2010**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **29/07/2016** BOPI nr. **7/2016**

(41) Data publicării cererii:
29/06/2012 BOPI nr. **6/2012**

(73) Titular:

- INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE - IMNR, BD.BIRUINȚEI NR.102, PANTELIMON, IF, RO;
- INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI, STR.ATOMIȘTILOR NR.409, MĂGURELE, IF, RO;
- UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, BD.MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.36-46, SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO;
- INSTITUTUL DE ȘTIINȚE SPATIALE, STR.ATOMIȘTILOR NR.409, MĂGURELE, IF, RO

(72) Inventatori:

- SOARE VASILE, BD.THEODOR PALLADY NR.29, BL.N3 - N3 A, SC.A, AP.9, SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO;
- BURADA MARIAN, STR.STRAJA NR.3, BL.62 BIS, SC.2, AP.26, SECTOR 4, BUCUREȘTI, B, RO;
- MITRICĂ DUMITRU, BD. 1 DECEMBRIE NR.30, BL.Z4, SC.6, PARTER, AP.66, SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO;

- CONSTANTIN IONUT, BD.BASARABIA NR.67, BL.A 16, SC.A, ET.3, AP.10, SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO;
- ANTOHE ȘTEFAN, STR.VICINA NR.2, BL.29, ET.1, AP.7, SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO;
- ION LUCIAN, STR. RÂUL ȘOIMULUI NR.5, BL.27, SC.2, ET.2, AP.30, SECTOR 4, BUCUREȘTI, B, RO;
- LUNGU PETRICĂ CRISTIAN, CALEA MOȘILOR NR.241, BL.47, SC.3, ET.7, AP.92, SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO;
- POROSNICU CONSTANTIN CORNELIU, STR.GEORGE BACOVIA NR.10, SC.A, AP.5, BACĂU, BC, RO;
- GHENESCU MARIAN, STR.RĂSĂRITULUI NR.1, BL.118, SC.2, AP.95, ET.10, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
- GHENESCU VETA, STR.RĂSĂRITULUI NR.1, BL.118, SC.2, ET.10, AP.95, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:

C. SENE, B. NDIAYE, M. DIENG, B. MBOW AND H. NGUYEN CONG, "Culn(SeS)² BASED PHOTOVOLTAIC CELLS FROM ONE-STEP ELECTRODEPOSITION", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, VOL. 4(10), PP. 562-570, 2009; US 5501786; US 2006/0151331 A1

(54) **PROCES ELECTROCHIMIC DE OBȚINERE FILME SUBȚIRI CIS PENTRU APLICAȚII FOTOVOLTAICE**

Examinator: ing. chimist PIȚU MARCELA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 127532 B1

1 Inventia se referă la un proces de obținere electrochimică de filme subțiri din aliaje
 2 CulnSe, depuse pe un substrat de Ni, pentru aplicații în celule solare fotovoltaice de tip CIS.

3 La nivel mondial, piața celulelor solare este încă dominată de instalații fotovoltaice
 4 care utilizează drept semiconductori absorbanți filme de Si mono și policristalin, care prezintă
 5 o serie de dezavantaje majore: Si prezintă o bandă interzisă indirectă, este cel mai slab
 6 absorbant semiconductor folosit la celule solare, și necesită cea mai mare grosime pentru
 7 a absorbi radiația solară. De aceea, este nevoie de cel puțin de 10 ori mai mult Si pentru
 8 absorbția unei fracțiuni date de lumina solară, comparativ cu semiconducțorii Culn(Ga)Se.
 9 Superioritatea acestor materiale derivă din următoarele caracteristici: prezintă o bandă
 10 interzisă directă, care generează o capacitate de absorbție mărită, și necesită o grosime de
 11 100 de ori mai mică decât straturile de Si, pot fi depuse pe substraturi relativ ieftine, cum ar
 12 fi sticla, folii metalice și materiale plastice, sunt depuse continuu pe suprafețe mari, la
 13 temperatură mult mai scăzută (200...500°C vs. ≈ 1400°C pentru c-Si), pot tolera conținuturi
 14 mai mari de impurități (necesitând deci purificări mai puțin costisitoare, în cazul materiei
 15 prime) și sunt integrate cu ușurință într-un modul monolitic interconectat.

16 Procedeele cunoscute, pentru obținerea materialelor semiconductoare CulnSe, sunt:
 17 depunere epitaxială cu fascicul molecular (MBE), depunere chimică din vapi (CVD),
 18 depunere chimică din baie, evaporare, depunere în plasmă. Dintre aceste procedee, unele
 19 au fost experimentate numai la nivel de laborator, însă numai două dintre ele au fost
 20 dezvoltate comercial: coevaporarea, care permite formarea aliajului prin evaporarea
 21 simultană a Cu, In și Se din sursă, pe un substrat încălzit, și procesul denumit selenizare,
 22 în care straturile de Cu și In sunt depuse prin diverse metode pe un substrat, fiind încălzite
 23 apoi în prezența Se dintr-un gaz cum ar fi H₂Se sau a Se în stare de vapi, adăugând astfel
 24 cel de-al treilea constituent al aliajului. Temperaturile substratului ating de obicei valori de
 25 la 500 până la 600°C în timpul unor etape ale creșterii. De obicei sunt utilizate substraturi de
 26 sticlă acoperită cu Mo, dar sunt investigate și foile de metal sau plastic.

27 Procedeele actuale de obținere a CulnSe și a altor materiale semiconductoare
 28 (CulnGaSe, CdTe) prezintă o serie de dificultăți și dezavantaje, între care: numărul mare de
 29 etape tehnologice, procesarea la temperaturi relativ înalte, condiții speciale de vid înaintat
 30 sau presiune, utilaje și echipamente complexe (cupoare cu flux de electroni, plasmă etc.),
 31 controlul dificil al compozitiei aliajului, prețuri de cost ridicate. În stadiu experimental, de
 32 cercetare, se află diverse procedee electrochimice de obținere a filmelor subțiri binare Culn,
 33 CdTe și ternare Culn(Ga)Se, printr-un proces de electrodepunere simultană, într-o singură
 34 etapă sau în mai multe etape (depunerea secvențială de straturi de Cu și In), cu depunerea
 35 ulterioră, prin alte metode fizice, a celui de-al treilea element (Se, Ga etc.). Drept substrat
 36 conductor au fost utilizate folii de Mo. În cele mai multe cazuri, electrodepunerea simultană
 37 de straturi CIS a fost efectuată în regim potențiosstatic simplu, în celule cu doi sau trei
 38 electrozi. Electrolitii utilizați au fost amestecuri de sulfati, cloruri, oxizi de Se.

39 Este cunoscută, din brevetul **US 5501786**, o metodă de obținere a unui compus
 40 CulnSe₂ prin depunere galvanică, prin crearea unui substrat conductiv electric, depunerea
 41 pe substrat a unui prim strat de In sau Cu, apoi al doilea strat de Cu, încorporarea Se sub
 42 formă de particule, și formarea CulnSe prin reacția termică.

43 De asemenea, se cunoaște, din brevetul **US 2006/0151331 A1**, o metodă de obținere
 44 de filme subțiri de CulnGaSe, combinate prin electrodepunere realizată prin adăugarea de
 45 sulfat de sodiu dodecil într-o baie de electroliză, pentru a se putea încorpora galu în filmele
 de CIGS.

<p>În lucrarea C. Sene, B. Ndiaye, M. Dieng, B. Mbow and H. Nguyen Cong "Culn(SeS)₂ based photovoltaic cells from one-step electrodeposition", International journal of Physical Sciences , Vol 4(10), pp. 562-570, October, 2009, este cunoscut faptul că, pentru obținerea de filme subțiri fotovoltaice, policristaline, de CulnSe, depuse pe molibden, procesul de electrodepunere se realizează utilizând CuSO₄, In₂(SO₄)₃ și SeO₂ cu LiSO₄, și tratând cristalele în atmosferă de H₂S la 575°C.</p> <p>Problema tehnică va consta în codepunerea Cu, In și Se pentru obținerea de filme subțiri, într-o singură etapă, pe un suport catodic cu consum energetic redus, utilizând, ca materii prime, sulfați și oxizi în loc de metale.</p> <p>Procedeul propus pentru obținerea de filme subțiri Cu-In-Se printr-un proces electrochimic desfășurat în regim galvanostatic, într-o singură etapă, constă în esență în codepunerea Cu, In și Se pe un suport catodic format dintr-un strat de Ni depus pe o folie de material plastic, utilizând drept electrolit un amestec de soluții de sulfat de Cu, sulfat de In și oxid de Se. Se obțin filme subțiri CulnSe cu grosimi de 2...5 μm și compozitii apropiate de compozitia stoichiometrică a compusului CulnSe₂, care sunt ulterior tratate termic, pentru îmbunătățirea cristalinității și a compozitiei fazice.</p> <p>Procedeul conform inventiei are ca fundament procesele electrochimice de reducere a speciilor active ale metalelor ce alcătuiesc filmul subțire, procese exprimate prin reacții caracteristice care sunt prezentate în continuare.</p> <p>Pentru Cu: Cu²⁺ + 2e⁻ ⇌ Cu, cu un potențial de descărcare ε = + 0,342 V.</p> <p>Pentru In: In³⁺ + 3e⁻ ⇌ In, cu un potențial de descărcare ε = - 0,338 V.</p> <p>Pentru Se: HSeO₂⁺ + 4H⁺ + 4e⁻ + OH⁻ ⇌ H₂SeO₃ + 4H⁺ + 4e⁻ ⇌ Se + 3H₂O, cu un potențial de descărcare ε = + 0,74 V.</p> <p>Deși potențialele de descărcare ale celor trei metale sunt diferite, depunerea electrochimică simultană este posibilă datorită utilizării unor agenți de complexare ce deplasează potențialul de depunere al Cu spre valori negative, dar și prin folosirea unor concentrații diferite ale cationilor metalelor în electrolit și ajustării valorii pH.</p> <p>În cadrul procesului de electrodepunere CIS s-a utilizat o celulă de electroliză cu capacitatea de 500 cm³, cu trei electrozi. Electrodul de referință a fost constituit dintr-un electrod de calomel saturat (ECS), iar drept contraelectrod (anodul) a fost utilizată o placă din platină. Electrodul de lucru (catodul) este reprezentat de un strat subțire de Ni placat pe o folie de kapton. Procesul de electrodepunere și monitorizare a variației tensiunii și curentului a fost realizat cu un potențiosstat/galvanostat model Princeton Applied Research 263 A, cu interfață PC. Celula de electroliză a fost încălzită electric, pentru a menține temperatura de lucru la valorile dorite. Agitarea electrolitului s-a realizat cu ajutorul unui agitator magnetic.</p> <p>Parametrii principali ai procesului de electrodepunere sunt: compozitia electrolitului, tensiunea aplicată (0,7...1,0 V), intensitatea curentului (5...20 mA), timpul de depunere (15...60 min). După procesul electrochimic, foliile depuse cu stratul subțire CIS sunt spălate cu apă bidistilită, pentru îndepărtarea urmelor de electrolit, și uscate în curent de Ar. Pentru îmbunătățirea cristalinității și a compozitiei chimice și structurale a filmelor CIS depuse electrochimic, acestea sunt tratate termic la o temperatură de 300...350°C, în atmosferă inertă (Ar purificat).</p> <p>Invenția, comparativ cu metodele cunoscute de obținere a filmelor subțiri de aliaj CulnSe, prezintă următoarele avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizează materii prime mai ieftine, respectiv, sulfați și oxizi ai metalelor componente ale aliajului, în loc de metale pure, scumpe și deficitare; - proceul implică un număr mic de operații, cu durate reduse, cu consumuri scăzute de materii prime și energie; 	<p style="margin-bottom: 10px;">1</p> <p style="margin-bottom: 10px;">3</p> <p style="margin-bottom: 10px;">5</p> <p style="margin-bottom: 10px;">7</p> <p style="margin-bottom: 10px;">9</p> <p style="margin-bottom: 10px;">11</p> <p style="margin-bottom: 10px;">13</p> <p style="margin-bottom: 10px;">15</p> <p style="margin-bottom: 10px;">17</p> <p style="margin-bottom: 10px;">19</p> <p style="margin-bottom: 10px;">21</p> <p style="margin-bottom: 10px;">23</p> <p style="margin-bottom: 10px;">25</p> <p style="margin-bottom: 10px;">27</p> <p style="margin-bottom: 10px;">29</p> <p style="margin-bottom: 10px;">31</p> <p style="margin-bottom: 10px;">33</p> <p style="margin-bottom: 10px;">35</p> <p style="margin-bottom: 10px;">37</p> <p style="margin-bottom: 10px;">39</p> <p style="margin-bottom: 10px;">41</p> <p style="margin-bottom: 10px;">43</p> <p style="margin-bottom: 10px;">45</p> <p style="margin-bottom: 10px;">47</p> <p style="margin-bottom: 10px;">49</p>
--	---

1 - procedeul permite obținerea de materiale semiconductoare film subțire CIS într-o
2 singură etapă, fără a necesita depunerea ulterioară a celui de-al treilea metal - Se, printr-un
3 procedeu dificil;

4 - filmele subțiri au o cristalinitate bună și o compozitie stoechiometrică foarte
5 apropiată de a compusului $CuInSe_2$;

6 - filmele depuse electrochimic sunt omogene, compacte, au o aderență ridicată pe
7 stratul de Ni și o grosime uniformă de 2...3 μm.

8 Celula de electroliză, pentru obținerea de filme subțiri CIS prin codepunere
9 electrochimică, constă dintr-o cuvă de capacitate 500 cm³, confecționată din sticlă 1, catodul
10 2 este constituit dintr-o folie de kapton placată cu Ni pe o suprafață de 11 x 35, care a fost
11 atașată mecanic de o suprafață rigidă și plană, din material izolator. Contactul electric dintre
12 stratul de Ni și sursa de curent s-a realizat prin intermediul unei cleme metalice. Anodul 3 a
13 fost realizat dintr-o placă din platină cu dimensiuni de 30 x 30 x 0,5 mm, iar drept electrod
14 de referință 4 a fost utilizat un electrod de calomel saturat (ECS). Distanța dintre anod și
15 catod poate fi variată, în funcție de necesitățile tehnologice. Pentru încălzirea și agitarea
16 electrolitului, în timpul procesului s-a folosit un încălzitor-agitator magnetic cu turărie
17 variabilă, cu agitator metallic încastrat în teflon 5.

18 Schița celulei de electroliză este prezentată în figură.

19 Pentru obținerea unor filme subțiri din aliaj $CuInSe$, cu o grosime de 2 μm și o
20 compozitie corespunzătoare compusului $CuInSe_2$, conform invenției, se efectuează operațiile
21 descrise în continuare:

22 Se pregătește o cantitate de 500 cm³ de electrolit cu următoarea concentrație: $CuSO_4$
23 · 5H₂O - 5 mM; $In_2(SO_4)_3$ - 10 mM; SeO_2 - 10 mM. Valoarea pH-ului soluției de electrolit după
24 preparare este de 1,8, și se corectează la valoarea de 2,5 cu soluție de NaOH (20%). Se
25 adaugă o cantitate de 0,5 cm³ alcool etilic, cu rolul de a diminua activitatea apei în timpul
26 procesului de electroliză, respectiv, a ionilor de hidrogen. În timpul procesului electrochimic,
27 se elimină tendința de creștere a pH-ului prin adăugarea de H_2SO_4 .

28 Folia de kapton placată cu Ni prin depunere din plasmă, prin metoda arcului
29 termoionic în vid, este tăiată în bandă cu dimensiunile: 11 x 35 mm și, înainte de a fi fixată
30 în dispozitivul de prindere al celulei de electroliză, este degresată cu acetonă, spălată cu apă
31 bidistilită și uscată în curenț de aer cald. După alimentarea electrolitului în cuva de
32 electroliză, se pornește procesul electrochimic, în regim galvanostatic, cu următorii
33 parametri: tensiunea: 1 V; intensitatea curențului: 10 mA; temperatură de lucru: 40°C; timp
34 de electroliză: 30 min; distanța anod-catod: 20 mm. La finalul procesului, folia cu stratul
35 subțire CIS depus este spălată cu apă bidistilită, pentru îndepărtarea urmelor de electrolit,
și uscată în curenț de argon purificat.

36 Ulterior, filmul de $CuInSe$ este tratat termic, în vederea îmbunătățirii cristalinității, a
37 aderenței pe substratul de Ni și pentru eliminarea fazelor parazite. Operația de tratament
38 termic va consta în menținerea filmului CIS la o temperatură de 350°C, timp de 45 min, în
39 atmosferă de Ar purificat. Pentru a împiedica evaporarea Se și a In, folia de CIS este fixată
40 într-un dispozitiv tip sandviș, între 2 plăci de sticlă strânse cu ajutorul unor cleme de oțel.

41 În final a fost obținut un film subțire $CuInSe_2$, cu caracteristici chimico-structurale și
42 electrono-optice corespunzătoare pentru utilizarea acestui material în aplicații fotovoltaice.

RO 127532 B1

Revendicări	1
1. Procedeu de obținere a unor filme subțiri de CuInSe prin codepunere electrolitică în soluții de sulfat de cupru, sulfat de indiu și oxid de seleniu, utilizând drept catod un strat de nichel depus pe o folie de kapton, anodul fiind realizat dintr-o placă de platină și un electrod de calomel saturat, caracterizat prin aceea că respectiva codepunere electrochimică are loc într-o soluție uzuală de electrolit, la care se adaugă un agent de reducere a activității apei și un agent de complexare, la o temperatură de 25...40°C, o tensiune aplicată 0,7...1 V, o intensitate a curentului de 5...20 mA, o distanță anod-catod de 10...20 mm și un raport al suprafețelor anod/catod de 1,5...2/1, codepunerea fiind urmată de un tratament termic sub atmosferă de argon, la o temperatură de 350°C, timp de 45 min.	3
2. Procedeu conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că , în soluția de electrolit, concentrațiile speciilor active sunt: 5...10 mM $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 10...30 mM $\text{In}_2(\text{SO}_4)_3$, 5...10 Mm SeO_2 , agentul de reducere al activității apei este alcoolul etilic, iar agentul de complexare este acidul gluconic.	5
	7
	9
	11
	13
	15

(51) Int.Cl.

B01J 19/08 (2006.01),

C01B 19/00 (2006.01),

H01L 21/20 (2006.01)

